

证券代码：300567

证券简称：精测电子

公告编号：2024-087

武汉精测电子集团股份有限公司

关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年4月21日、2024年5月14日召开第四届董事会第三十五次会议、2023年度股东大会，审议通过《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》，为保证公司及下属各子公司的正常生产经营，拓宽资金渠道，公司或子公司拟对子公司2024年度向银行申请综合授信提供保证担保，担保总额不超过38.5亿元人民币；其中，公司拟对子公司上海精测半导体技术有限公司（以下简称“上海精测”）向银行申请授信提供最高担保额度人民币8.3亿元，授信品种：流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内信用证、票据贴现、票据池、商业保理以及其他方式，最终以各家银行实际审批的授信额度及授信期限为准。具体内容详见公司于2024年4月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于为子公司向银行申请授信提供担保的公告》（公告编号：2024-059）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关法律法规的最新规定，具体担保进展情况披露如下：

二、担保进展情况

为满足子公司上海精测日常经营发展需要，公司近日与中国工商银行股份有

限公司上海长三角一体化示范区支行（以下简称“工商银行”）签订编号为“27241000031101”的《最高额保证合同》，约定公司为上海精测向工商银行于保证额度有效期内发生的一系列授信业务合同提供连带责任保证担保。

上述担保属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为上述子公司提供担保额度范围内，无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

三、担保合同的主要内容

（一）《最高额保证合同》（编号：27241000031101）

1、债权人：中国工商银行股份有限公司上海长三角一体化示范区支行

2、保证人：武汉精测电子集团股份有限公司

3、债务人：上海精测半导体技术有限公司

4、保证额度有效期自2024年5月20日起至2029年5月20日

5、保证最高本金限额为人民币：贰亿元整

6、保证方式：连带责任保证

7、保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

8、保证期间：若主合同为借款合同或贵金属租借合同，则本合同项下的保证期间为：自主合同项下的借款期限或贵金属租借期限届满之次日起三年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租借提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租借提前到期日之次日起三年。若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起三年。若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起三年。若主合同为信用证开证协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起三年。若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。

四、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告日，公司的所有对外担保仅限于纳入公司合并财务报表范围内的公司，担保方式为连带保证责任担保；公司及子公司尚处有效期内的实际对外担保总额为 81,637.85 万元（不含子公司对公司的担保），占公司截至 2023 年 12 月 31 日净资产的 22.03%。公司及子公司无逾期对外担保事项，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。

五、备查文件

1、《最高额保证合同》。

特此公告。

武汉精测电子集团股份有限公司

董事会

2024年5月23日